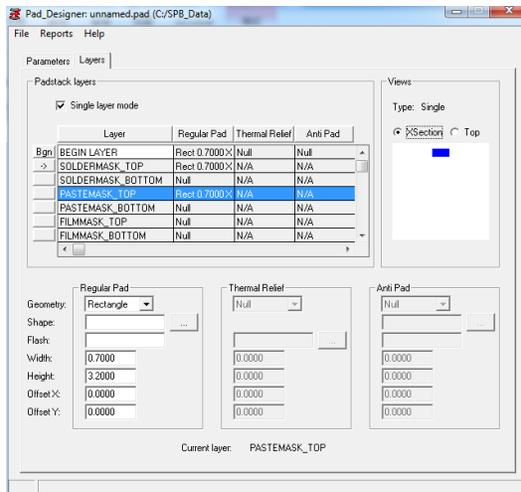




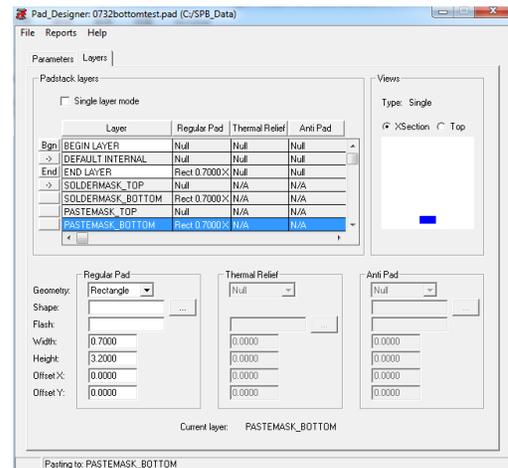
## Allegro 制作双侧表贴封装

### 制作焊盘

因为我们要在 Top 层和 Bottom 层都放置焊盘, 所以在制作焊盘的时候就需要制作两种类型的焊盘, 一种对应 Top 层, 一种对应 Bottom 层. 首先来制作 top 层的焊盘, 打开 Pad designer, 设置参数如下图:

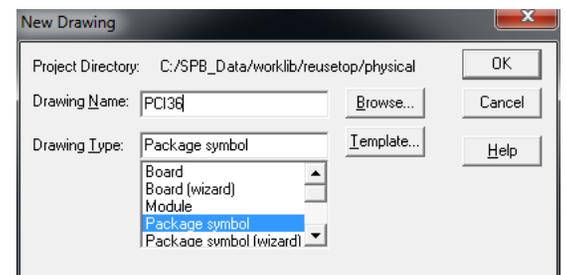


将上面的焊盘保存, 新建一个焊盘配置参数如下, 注意上下两图的不同.

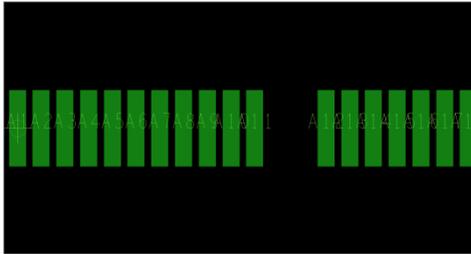


### 建立封装

焊盘建立完毕后我们需要建立封装, 打开 PCB Editor, 新建一个 Package Symbol



修改图纸尺寸及栅格点后开始放置焊盘, 先放置 top 层焊盘



然后放置 Bottom 层焊盘,



查看 3D 视图如下:



添加必须的丝印层、装配层、place bound 以及 RefDes 完成封装

### Comtech 解决方案

- Cadence PCB 设计平台建设
- ECAD/CIS 库平台建设
- Allegro 软件二次开发
- PCB 项目设计及仿真外包服务
- Cadence 软件培训服务

### Comtech 优势

- 实力雄厚的资深技术团队，多名 10 年以上经验的 FAE
- 丰富的 PCB 设计/EDA 平台建设等实践经验
- 出色的二次开发能力，为客户提供各种定制化开发需求
- 高效的技术服务平台，通过电话/邮件/Web/BBS，及时帮客户解决各类软件使用/设计相关问题
- 实战指导、项目现场支持等特色服务
- 最新技术资料下载客户专享通道，包括软件使用技巧、设计经验、国外技术文献翻译等
- 为客户提供量身定制的全面的针对性培训服务

### 联系方式

#### 科通数字技术有限公司

总部：深圳市南山区高新南九道微软科通大厦 8-11 层

产品经理：王其平

手机：18049720018

邮件：QipingWang@comtech.com.cn

地址：上海市徐汇区桂平路 426 号华鑫商务中心 2 号楼 7 层 03-04 室

#### 华东地区

联系人：陈敏敏

手机：18017922811

邮件：PeterChen@comtech.com.cn

地址：上海市徐汇区桂平路 426 号华鑫商务中心 2 号楼 7 层 03-04 室

华南及西部地区

联系人：谭波涛

手机：15920086575

邮件：terrytan@comtech.com.cn

地址：深圳市南山区高新南九道微软科通大厦 8-11 层

华北地区

联系人：党建成

手机：18010161381

邮件：SudyDang@comtech.com.cn

地址：北京市海淀区中关村大街 1 号海龙大厦 14 层北区 1418-21